



## 達能科技簽署新臺幣27億元聯合授信合約

太陽能矽晶圓廠達能科技(股票代號：3686)今日(4/1)與中國信託商業銀行等 15 家銀行共同簽署新臺幣 27 億元聯合授信合約。簽約儀式由達能科技趙元山董事長與各銀行代表共同主持。

本次聯貸案委由中國信託商業銀行、兆豐國際商業銀行、臺灣銀行、合作金庫商業銀行、彰化商業銀行、全國農業金庫銀行、臺灣土地銀行、臺灣中小企業銀行、玉山商業銀行、日盛國際商業銀行等十家銀行統籌主辦，並由中信銀擔任額度管理銀行，兆豐銀擔任擔保品管理銀行。本聯合授信案原欲籌組金額為新臺幣 25 億元，在十家統籌主辦銀行及華南商業銀行、高雄銀行、國泰世華商業銀行、新加坡商星展銀行、板信商業銀行等五家參貸銀行踴躍認購下，認購額度達新臺幣 53 億元，超額認購達 2 倍之多，最後協調以新臺幣 27 億元為授信簽署額度。

本次聯貸案資金主要用途係興建晶圓三廠廠房及購置機器設備，另用以償還金融機構借款及充實營運週轉金。達能近幾個月來接單暢旺，持續滿載生產，業績已連續 20 個月創新高。為因應客戶持續之需求，已於今年農曆年前動工興建新的廠房，啟動產能倍增計畫，預計於今年第三季完工裝機，年底總產能達 520MW。

### 聯絡人

代理發言人:吳育宜財務長

發言人電郵: [pr@danentech.com](mailto:pr@danentech.com)

<http://www.danentech.com/ir.html>

電話：+886 3 4738788 傳真：+886 3 4738368

### 關於達能

達能科技股份有限公司於 2007 年 11 月正式成立，為擁有專業技術的太陽能矽晶圓製造廠，主要生產太陽能光電產業使用的太陽能多晶矽錠(silicon ingot & brick)、太陽能多晶矽晶片(wafer)以及提供客製化產品的專業代工服務。達能科技生產基地位於桃園科技工業園區，目前擁有兩座晶圓製造廠，晶圓三廠正在興建中，預計年底前完工並投產。達能科技現有 600 位員工，經營團隊主要來自於國際級半導體大廠、金融業及太陽能相關產業的專業經理人及技術團隊所組成。未來達能科技期以成本優勢、客製化彈性及產品多樣性，成為台灣太陽能矽晶圓專業製造之領導廠商。